

## 即時リリース

### 投資家向け広報窓口：

Ed Lockwood

インベスターリレーションズ部門シニアディレクター

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

### メディア向け広報窓口：

Meggan Powers

コーポレートコミュニケーション部門シニアディレクター

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

**KLA-Tencor が高度な半導体パッケージングのための新しいポートフォリオを発表**  
**CIRCL-AP™ および ICOS® T830 がウェーハレベルから最終コンポーネントまでの高度なパ**  
**ッケージングをサポート**

カリフォルニア州ミルピタス発(2015年4月16日)。[KLA-Tencor Corporation \(NASDAQ:KLAC\)](#)は、高度な半導体パッケージング技術をサポートする2つの新しい装置、**CIRCL-AP™**および**ICOS® T830**を発表しました。ウェーハレベルのパッケージングに使用される多様なプロセスの特性評価とモニタを行うように設計された**CIRCL-AP**では、ウェーハの表面全体の欠陥検査、レビュー、および計測を高スループットで実行できます。**ICOS T830**は、完全に自動化された**IC**パッケージの光学検査を行い、高精度の**2D**および**3D**の測定値と共に、さまざまなデバイスタイプおよびサイズの最終的なパッケージ品質を高感度で判定します。両方の装置とも、**IC**メーカーや半導体組立検査受託会社(**OSAT**)の設備で画期的なパッケージング技術を導入する際に、より微細なパターンサイズや厳しいピッチ要件などの課題を解決するのに役立ちます。

「コンシューマモバイルエレクトロニクスは、より微細で高速かつパワフルなデバイスの製造を継続的に促進しています。高度なパッケージング技術は、帯域幅の増加やエネルギー効率の向上などのデバイス性能の優位性をもたらします。しかし、パッケージング製造の方法はより複雑になっています。平坦化CMPや高アスペクト比のエッチングなどの一般的な前工程の**IC**製造プロセスと、一時的なボンディングやウェーハ再構成のような独特なプロセスの実行を伴います。当社は、前工程の半導体製造プロセスの制御における専門知識と、主要な研究開発機関および業界の共同事業体での協力を通じて得た経験を組み合わせ、ウェーハレベルから最終コンポーネントまでのパッケージングの課題を解決できる、柔軟で効率のよい検査ソリューションを開発しました。」と**KLA-Tencor**の最高マーケティング責任者**Brian Trafas**は述べています。

CIRCL-APには、並列データ収集機能を利用する複数のモジュールが含まれており、高度なウェーハレベルのパッケージングプロセスを迅速でコスト効率よく制御します。CIRCL-APは、ウェーハレベルのチップスケールパッケージング、ファンアウトウェーハレベルパッケージング、シリコン貫通電極(TSV)を使用した2.5D/3D ICインテグレーションなどのさまざまなパッケージング技術をサポートしています。業界で実績のある8シリーズは、CIRCL-APの表面欠陥検査および計測モジュールとして機能します。LEDスキャン技術と自動欠陥分類機能を結合して、疑似欠陥を減らし、TSVクラックや再配線レイヤのショートなどの重大なパッケージング欠陥の検出を迅速に行います。KLA-TencorのVisEdge®テクノロジーをベースにしたCV350iモジュールでは、ウェーハエッジ欠陥の検出、自動欠陥分類、および自動レビューと、TSVプロセスフローにおける微細なエッジトリムやボンディング段差の計測が可能です。複数のイメージングおよび照明モードを備えたMicro300モジュールは、バンプ、再配線、およびTSVプロセスに必要な高精度の2Dおよび3D計測を生成できます。柔軟性の高いアーキテクチャを利用したCIRCL-APでは、ハンドラーが、貼り合わせウェーハ、薄膜ウェーハ、反のあるウェーハをサポートする一方で、1つ以上のモジュールを特定のパッケージングアプリケーションの要件に対応するよう構成できます。

ICOS T830は、業界屈指のICOSコンポーネント検査シリーズを拡張して、リードフレーム、ファンアウトウェーハレベル、フリップチップ、積層パッケージなどの高度なパッケージングタイプに関連する歩留まりの課題を解決します。強化されたパッケージ画像検査機能のxPVI™により、ボイド、スクラッチ、ピット、チップ、ワイヤ露出などのコンポーネントの上面及び下面の表面欠陥を高い感度で検出できます。最先端のメモリおよびロジックパッケージデバイスの品質基準が満たされていることを確認するために、ICOS T830は高速で3Dボール、リード、およびキャパシタの計測、パッケージ全高の測定、およびコンポーネント側面の検査を行います。xCrack+検査ステーションでは、マイクロクラック欠陥を正確に検出できます。この欠陥は、モバイルアプリケーションで使用される薄膜コンポーネントの主な不良メカニズムです。ICOS T830には、4つの独立した検査ステーションの並列処理機能と、検査対象のパッケージコンポーネントの高速分類機能が組み込まれており、高スループットでコスト効率のよいコンポーネント検査を実現します。

さまざまな構成の複数のCIRCL-AP装置が世界中で設置されており、TSV、ファンアウトウェーハレベルのパッケージング、その他のウェーハレベルのパッケージング技術の開発および製造に使用されています。ICOS T830装置は、世界中の多くのICパッケージング設備で使用されており、さまざまなデバイスタイプおよびサイズにわたるパッケージ品質に関して正確なフィードバックを提供しています。半導体パッケージングプロバイダが要求する高い性能と生産性を維持するために、CIRCL-AP装置およびICOS T830装置は[KLA-Tencorのグローバルで包括的なサービスネットワーク](#)によって支えられています。CIRCL-APおよびICOS T830の詳細については、[パッケージングプロセス制御のWebページ](#)をご覧ください。

KLA-Tencor について：

KLA-Tencor Corporation は、プロセス制御および歩留まり管理ソリューションにおけるリーディングカンパニーであり、検査および計測装置の最先端技術をお届けするパートナーとして世界中のお客様に信頼されています。これらの技術は半導体、LED、その他の関連ナノエレクトロニクス業界で利用されています。業界標準の製品ポートフォリオと世界に誇る研究者チームによって、約 40 年にわたりお客様に優れたソリューションを提供してきました。KLA-Tencor は、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、世界中に販売およびサービス拠点があります。詳細については、<http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)をご覧ください。

### 将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに記載されている過去の事例以外の事項、すなわち CIRCL-AP 装置および ICOS T830 装置に期待される性能、高度なパッケージング技術への CIRCL-AP 装置および ICOS T830 装置の拡張性、コンシューマモバイルエレクトロニクスにおける動向、KLA-Tencor の顧客により見込まれる CIRCL-AP 装置および ICOS T830 装置の用途、CIRCL-AP 装置および ICOS T830 装置の使用により実現可能な予想されるコストおよび運用上の利点およびその他の利点は将来の見通しであり、Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (1995 年私募証券訴訟改革法)の Safe Harbor (セーフハーバー)条項が適用されます。これらの見通しは現時点での情報と予想によるものであり、多くのリスクと不確定要素を含んでいます。新技術の採用の遅延(コストまたは性能上の問題などの原因による)、他社による競合製品の発売、当社製品の導入、性能、または使用に影響を及ぼす予期せぬ技術的な問題や限界など、さまざまな要因により、実際の結果はこれらの記述で予想された内容と著しく異なる場合があります。

###